

公司代码：688519

公司简称：南亚新材

南亚新材料科技股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn/> 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 234,771,002 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 5,811,149 股后的股本 228,959,853 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 73,267,152.96 元（含税）。

本年度公司现金分红总额 73,267,152.96 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 0 元，现金分红和回购金额合计 73,267,152.96 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.49%。以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 109,573,384.53 元，现金分红和回购并注销金额合计 182,840,537.49 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 76.08%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	南亚新材	688519	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张柳	郑小芳
联系地址	上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号	上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号
电话	021-69178431	021-69178431
传真	021-69177733	021-69177733
电子信箱	nanya@nouyatec.com	nanya@nouyatec.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主营业务系覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。覆铜板是制作印制电路板的核心材料，印制电路板是电子元器件电气连接的载体。覆铜板及印制电路板是现代电子信息产品中不可或缺的重要部件，被广泛应用于消费电子、计算机、通讯、数据中心、汽车电子、航空航天和工业控制等终端领域。

2、主要产品及服务情况

公司主要产品为覆铜板及粘结片，具体如下：

(1) 覆铜板

覆铜板（Copper Clad Laminate，简称CCL）全称为覆铜箔层压板，是将增强材料浸以树脂胶液，一面或两面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，是制作印制电路板的核心材料。覆铜板担负着印制电路板导电、绝缘、支撑三大功能，对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。

由于下游应用领域众多且性能需求各有差异，公司的产品明细规格繁多，按照胶系（树脂配方体系）大致可以分为普通FR-4、无铅兼容型FR-4（以下简称“无铅板”）、无卤无铅兼容型FR-4（以下简称“无卤板”）、高频高速、车用板、能源板、HDI及IC封装基材等。具体情况如下所示：

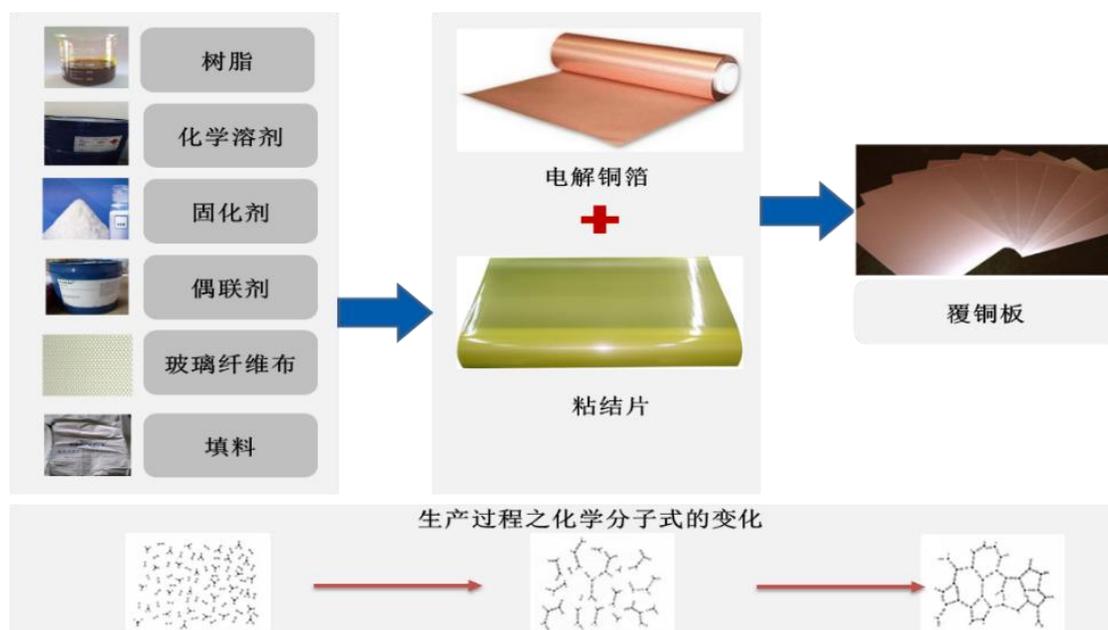
类别	代表型号/品牌系列	终端应用领域
普通板系列	NY1140、NY1600	家电、电视、电脑、游戏机等
无铅板	NY2140、NY2150、NY2150H、NY2170、NY2170H、NY2600	手机、电脑、仪表仪器、

系列		汽车电子等
无卤板系列	NY3150HF、NY3150HC、NY3170HF、NY3170HC、NY3150HF FR-15、NY3170HF FR-15	智能终端、笔记本电脑、硬盘、内存、服务器、汽车电子等
高速板系列	NOUYA2G+、NOUYA4G、NOUYA4G+、NOUYA6G、NOUYA6G+、NOUYA6GN+、NOUYA4、NOUYA6、NOUYA7、NOUYA7N、NOUYA7N+、NOUYA8U、NOUYA8N、NOUYA9、NOUYA2L、NOUYA3、NOUYA4L、NOUYA4GL、NOUYA7GL、NOUYA7G+、NOUYA7GNL、NOUYA8GNL、NOUYA8GUL、NOUYA4L+、NOUYA8GQL、NOUYA9GQL、NOUYA10GQL	AI 服务器 UBB、AI 服务器加速卡、核心网、承载网、核心路由、交换机、服务器、光模块、TRx、数据中心、低轨卫星、正交背板等
高频板系列	RF-FA220、RF-FA255、RF-FA265、RF-FA300、RF-HCA300、RF-HCA300H、RF-HCA330、RF-LA366、RF-LA438、RF-PA06、RF-PA08、RF-PA12、RF-MW-P、RF-MW	天线、功放、雷达、射频模组等
车用板系列	NY2150、NY-A1、NY3150HF、NY3150HC、NY2170、NY-A2、NY3170HC、NY3170M、NY-A3HF、NY-A5HF、NY-A5HC、NY-A6HF	智能电动（OBC，DCDC，高压电驱）充电桩、智能座舱、智能网联等
能源板系列	NY2150H、NY2170H、NY3150HC、NY-TC10G	光伏逆变器、储能、二次电源等
HDI 板系列	NY3150HF、NY3170HF、NY3170M、NY6180LL、NY3170LK、NY6180、NY3188HF、NY3198HF、NY3198HF (N)	手机、平板电脑、SSD、Ultra book、ETC 等
IC 封装基材系列	NY8320 ED、NY6600、NY8720、NY8720 LD、NY8320 LD、NY8320 NSA、NY8320 NSB、NY8320 NS、NY8320 NSC、NY8320 NSF、NY8320 NSF (LC)、NY8320、NSF (LCA)、NY8320 HD6、NY8320 HD6 (LD)、NY8320 HD8、NY8320 HD8 (LD)	射频模组、手机、硬盘、内存、CPU、GPU 等

(2) 粘结片

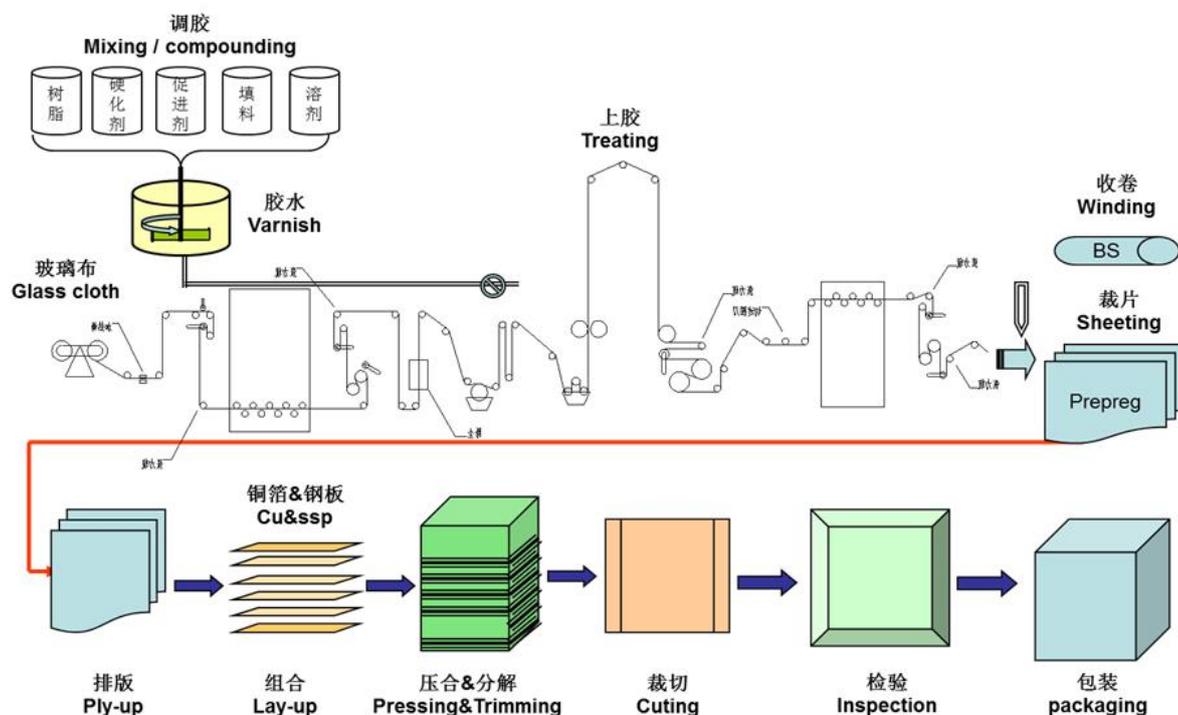
粘结片 (Prepreg, 简称 PP) 又称半固化片, 系覆铜板生产过程中的前道产品, 粘结片在较大程度上决定了覆铜板的整体性能, 系覆铜板产品的配方技术与核心附加值之体现。

覆铜板和粘结片的关系



下游多层板或 HDI 客户向覆铜板厂商采购覆铜板的同时，往往需要配套采购同厂商同规格的粘结片产品，用其作为多层板或 HDI 层与层之间的粘结和绝缘材料。粘结片的销售情况能很好地反映出覆铜板厂商服务于多层板或 HDI 等中高端领域的综合能力。

覆铜板的工艺流程如下图



2.2 主要经营模式

公司一贯秉承“以人为本、集思广益、持之以恒、共创大业”的企业发展精神，贯彻“市场导向、管理创新、质量至上、技术领先”的经营方针，科学管理、不断创新、稳健发展。公司紧跟行业及市场的发展趋势与需求，始终致力于“成为全球领先的 CCL 行业制造与方案解决公司”，通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系和落实有效管理措施，为全球客户提供绿色、安全、环保的产品以及优质的售前、售中和售后服务。

公司产品通过了 CQC 产品认证、德国 VDE 产品认证、日本 JET 产品认证、美国 UL 安全认证。公司采取系统的质量控制体系，先后通过了 IATF16949 质量管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证、QC080000 有害物质过程管理体系。

公司凭借多年的技术积累和品牌建设，已建立了集研发、生产、销售、服务等方面的综合性优势，在市场中形成了较高的知名度和良好的美誉度。公司已与奥士康、方正科技、广东骏亚、沪电股份、健鼎科技、景旺电子、胜宏科技、深南电路、生益电子等知名 PCB 厂商建立了长期良好的合作关系。

1、研发模式

公司根据行业技术发展动态并结合市场调研结果，制定研发项目计划并向研发中心下达研发任务，评审立项后进入新产品的配方开发、内部测试、打样测试、量化转产、配方持续优化等阶段。产品研发主要以产品配方优化升级和新产品开发为主。

(1) 产品配方优化升级主要考虑成本优化和性能升级。公司根据市场变化及客户需求，对成熟产品原有配方技术进行更新升级达到成本优化或性能升级或两者兼具，以满足客户需求，增强

市场竞争力。

(2) 新产品开发主要为公司战略研发产品的开发或头部终端技术合作的新品开发。由公司根据中长期战略目标或头部终端新品技术合作需求明确研发方向后，由研发中心组织成立专门项目组，对新项目研发可行性、研发周期及成本，调研分析后提交公司审批立项。其中，项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成，采用并行工作的方式，有效地提高研发的成功率、缩短开发周期，并降低开发成本。

2、采购模式

公司生产所需的原材料主要为电子铜箔、玻璃纤维布和树脂等。公司高度重视原材料供应体系建设，已建立合格的供应商评价体系，通过与上游知名供应商建立稳定的战略合作关系，保证原材料供应的稳定。公司采购部门负责定期询价，根据原材料需求计划，综合考虑交期因素，在询价、议价、比价的基础上选择合格供应商下单并签订采购合同。

3、生产模式

公司实行“以销定产及需求预测相结合”的生产模式。公司以市场需求为导向，根据已接订单、销售预测、经营目标的情况制定生产计划。生产部门根据生产计划严格按照工艺标准组织生产，按时、保质、保量的提供满足客户需求的产品。在质量控制体系上，公司实行全面质量管理，全员共同参与并贯穿于设计到制造的全过程。

4、销售模式

公司坚持以客户为中心，“持续为客户创造更大的价值”，实现客户与公司可持续性共赢发展。产品销售以直销为主，以终端(OEM/ODM)及PCB客户需求为方向，持续扩大市场品牌影响及市场份额为目标，积极主动开发各领域内客户及新项目，采取“重要策略客户为先”、“重大优质项目为先”销售策略。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业发展阶段及其基本特点

根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017)，公司所处行业属于“C3985 电子专用材料制造”。电子专用材料是支撑信息技术产业发展的基石，是保障产业链、供应链安全稳定的关键。近年来，国家颁布了一系列政策法规，将信息技术和电子专用材料制造确定为战略性新兴产业之一，大力支持其发展。随着5G/6G、AI算力、新能源汽车、智能驾驶和智能家居为代表的产业蓬勃发展，给覆铜板材料持续带来新的发展机遇。

2025年，覆铜板行业处于成熟期向高端化升级期的关键过渡阶段，行业整体呈现“总量稳增、结构分化、供需错配、国产替代提速”的核心特征，正加速从规模扩张向价值提升转型。主要体现以下基本特点：

1、结构性供需失衡：中低端市场产能过剩、价格内卷持续，高端市场产能不足，成为行业核心增长极。

2、高端市场动能强劲：AI、服务器、存储领域增速最快，同比增长超40%，传统消费类中低端市场进入存量竞争。

3、国产替代加速：内资企业高端领域市场份额提升，头部企业实现部分核心技术突破，但部分高端原材料仍有一定程度进口依赖。

4、行业分化加剧：头部企业加大研发投入、向高端升级，市场集中度提升；中小企业因研发不足，存量竞争压力凸显。

(2) 主要技术门槛

覆铜板的终端应用广泛而复杂，且下游技术更新换代不断加快，故对覆铜板企业的综合技术创新能力要求较高，而其研发及制造技术又是一项多学科相互交叉、相互渗透、相互促进的高

新技术，是一个复杂的系统工程。随着行业技术的不断升级换代，覆铜板企业不仅需要全面掌握并提升生产工艺，把控好品质的同时降低成本，确保生产出价优质好的产品，更需要应对终端不断提升的技术新需求研发创新出适用于市场的新品。

覆铜板的配方技术、生产工艺、量产品控均极其复杂。现阶段主要技术门槛体现在以下几个方面：

1、核心配方壁垒。这是竞争核心，需在低介电、高耐热、加工性与成本间精准平衡，复合改性体系研发难度大。

2、量产可靠性壁垒。这是规模化应用关键，高端产品对批次稳定性、高低温耐受性要求严苛，国内厂商在批次均匀性与生产工艺精度上与国际领先存在一定差距。

3、产业链协同壁垒。行业已逐步向“方案解决商”转型，需深度联动上下游，具备长期研发定力与联合攻关能力。

4、核心原物料供应壁垒。部分上游高阶材料仍需依赖进口。如超低轮廓铜箔等高端材料仍依赖进口，供应链稳定性与成本管控难度大。

不同应用领域对覆铜板性能的需求

应用领域	应用效果示意图	覆铜板性能需求偏好
手机		<ul style="list-style-type: none"> •智能手机：HDI 板，轻薄化、良好的刚性(超薄 PP)、低膨胀系数、信号稳定性、高耐热、Low Dk & Low CTE (Any layer)、SLP； •手机天线：载板 (AiP) 基材，耐 Package Assembly 条件、超低 CTE 以及 Low Dk；
通信基站		<ul style="list-style-type: none"> •Sub6G 基站天线：高频板，Dk 稳定、Low Df、厚度均一性好、耐 CAF； •基站功放除上述要求外，还对热导率、尺寸稳定性及吸水率有严格要求； •AAU-TRX 单元、BBU：高速板，Low CTE、Low Dk、Low Df、高耐热、耐 CAF、TCT、尺寸稳定性等； •毫米波天线：高速板，Low DK、Low Df、一致性、高可靠性、尺寸稳定性、耐老化等；
网络设备		<p>通信网络设备（交换机/路由器/光模块等）：高速板，Low DK 玻布需求、Low Dk、Low Df，高耐热、耐 CAF、TCT、尺寸稳定性，适用于混压、HDI 制程需求等；</p>
服务器		<p>服务器：高速板，Low Dk、Low Df，同时超薄、高耐热、耐 CAF、TCT、尺寸稳定性，优异的性价比等；</p>
AI 服务器		<p>AI 服务器：高速板，VLL、ULL、ELL 层级材料、Low CTE、适应于 5 阶以上 HDI、高多层+HDI、高多层混压需求、批次间稳定性、Low D 玻布需求、良好的 PCB 加工性等；</p>
计算机		<ul style="list-style-type: none"> •计算机主板部分： <ul style="list-style-type: none"> —高性能：电竞、AI PC 等产品电性能向高速材料方向发展； —超薄型：HDI 设计、良好的刚性（超薄 PP）及低膨胀系数要求； •计算机显示部分（TFT LCD 为主）：板材厚度均匀性、T1 等尺寸稳定性、优异的耐热性；

可穿戴设备		<ul style="list-style-type: none"> •可穿戴 Watch: 载板 SiP (SLP) 用基材, 超小面积高层数 (Anylayer)、耐 Package Assembly 条件、超低 CTE 以及超薄材料加工能力;
汽车		<ul style="list-style-type: none"> •传统汽车安全单元: 高可靠材料, 可靠性强、耐热、耐湿、低膨胀、耐 CAF、TCT 等; •新能源汽车: 智能座舱: FR4 及高速材料, HDI 制程、高可靠性; 智能电动: High Tg、高电压 CAF1000/1500V 及厚铜等; 智能网联: 高速材料, low Dk/Df、高可靠性; 智能驾驶: 高频板, LowDk 和 LowDf 且稳定、板厚均匀、耐 CAF、加工性能好;
显示		<ul style="list-style-type: none"> •LED (大型显示器): Low CTE、高刚性和高平整度、可靠性强 (耐冷热冲击)、厚度均匀、色泽一致性; •LED (背光模组): 高散热& 高耐热板, 优异的散热性&耐热性、高反射率等; 载板基材 (用于手机及平板等), 除前述要求外, 还需满足高刚性、高平整度; •LED 驱动类: 可靠性强、耐热、耐湿等;

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

电子信息产业发展为覆铜板行业提供了广阔的市场空间。随着产业链往中国本土的转移, 公司凭借较强研发设计能力、本土化服务优势、快速的服务响应能力和优质的性价比等方面优势, 已发展成为具有较强规模、技术和市场优势的覆铜板行业领先企业之一。

2025 年, 覆铜板行业处于成熟期向高端化升级的关键过渡阶段, 结构性供需失衡、国产替代提速、行业分化加剧的特征显著, 头部企业优势持续凸显。在此背景下, 公司核心依托高端高速产品突破与国产替代红利, 与行业龙头差距逐步缩小, 整体呈现“快速追赶、聚焦高端”的发展态势, 行业地位较 2024 年实现跨越式提升。主要体现在以下几个方面:

1、业绩增速领跑行业, 成为行业地位提升的核心支撑。以 2025 年三季度公开财务数据来看, 公司在成长性及盈利增速方面稳居行业前列, 彰显出强劲的发展势头。结合 2025 年业绩快报, 公司实现营业总收入 52.28 亿元, 同比增长 55.52%, 归母净利润 2.40 亿元, 同比增长 377.60%, 扣非归母净利润 2.18 亿元, 同比增长 677.46%, 盈利增速大幅领先国内大部分同行企业。

2、高端细分领域技术突围, 基本奠定细分行业第一梯队水准。公司聚焦高速覆铜板赛道, 已成功开发出高速全系列产品, 全面覆盖 M2~M10 层级。公司是内资率先全系列 (M2~M9) 高速产品通过国内核心终端认证的 CCL 厂商之一, 其中 M6~M8 产品已批量应用于国内头部算力客户, M9 层级处于 NPI 项目导入阶段。2025 年 Q4 公司在全球率先推出 M10 层级材料, 应对后续高速背板等产品的更高速率需求。目前该等级产品尚在海外核心算力终端认证过程中, 存在认证不通过的风险。现阶段, 公司在高速细分领域与全球优秀同行已处于“并跑”水平, 甚至在高阶高速产品部分性能已具备一定领先优势。随着核心技术的持续突破, 技术壁垒不断增厚, 差异化竞争优势增强。

3、国内外客户拓展成效显著, 为后续增长提供支撑。2025 年, 国内客户推出的大模型及超节点, 自主开发昇腾、海光等系列已经实现市场批量交付。公司在国内前述头部客户均已经实现量产导入, 其中 M6、M7 层级的材料在 2025 年实现稳定且高质量的量产交付, 成为当年度业绩增长

核心引擎之一。目前，公司除深耕国内高阶市场外，正重点开发北美、韩国、中国台湾地区等头部 ODM 及终端客户，高阶材料（M8 及以下等级）已通过部分海外终端客户认证。海外市场的进一步拓展将成为公司后续高速材料业务的重要增长极之一。

4、公司供应链自主可控优势明显。作为高速材料领域国产替代的标杆企业，通过产业链协同，公司已基本完成原材料的国产化认证。在高速 M8 等级及以下已实现原材料全 C 供应，在高速更高等级产品除个别核心原物料外，也基本实现国产替代。故公司产品不仅具备良好的供应安全边际，还拥有极高的性价比。

风险提示：全球宏观经济、行业竞争格局、终端需求不确定性及地缘政治变化，可能对公司经营业绩和发展规划带来不利影响；公司可能面临技术研发迭代、新产品认证及客户导入进度不及预期的风险；AI 算力爆发带动高端 CCL 需求激增，其上游核心原材料供给高度集中、扩产周期长，叠加海外产能受限，存在产业链保供与成本管控的风险。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

覆铜板作为印刷电路板（PCB）的核心基材，其发展紧密跟随电子信息产业的升级浪潮。2025 年，行业正经历深刻变革，主要呈现以下发展新情况：

1、材料技术持续创新突破。高频高速材料成为主流：为满足 5G/6G 通信、高速服务器、高端路由器的需求，Low Dk、Low Df 的覆铜板研发与量产加速。2025 年，全球范围内 M8 等级及以下产品已实现量产，更高频率、更低损耗的新材料体系持续演进。为适配大尺寸芯片、高多层线路板加工及先进封装应用需求，达到降低覆铜板与芯片间的热膨胀失配程度，减少产品翘曲、开裂等问题，提升尺寸稳定性与可靠性等目的，驱动覆铜板材料向 Low CTE 方向发展。

2、覆铜板需求正从传统的消费电子，向更具增长潜力的战略新兴领域迁移：在人工智能与算力基础设施领域，随着 AI 服务器、数据中心、交换机对高速、高多层覆铜板需求暴增，推动高层数、低损耗 CCL 产品发展；在新能源汽车与车载电子领域，汽车“三化”（电动化、智能化、网联化）驱动高导热、高可靠性、厚铜覆铜板市场快速扩张；在先进封装与半导体集成上，用于 FC-BGA 等先进封装的核心基材材料需求将愈加旺盛，覆铜板企业向高端 IC 封装基材发展必要性增强；在卫星互联网与低空经济领域：低轨卫星星座、无人机、eVTOL 等新业态，对轻量化、高可靠、适应复杂环境的覆铜板提出新的要求。

3、产业链协同与服务进一步延伸。首先“材料-制造-应用”一体化协同需求提升。领先企业不再局限于材料单一生产，而是加强与上游树脂、铜箔、玻纤布厂商的技术合作，并向下游 PCB、OEM/ODM 及终端客户提供“材料+解决方案”的一体化服务，深度参与客户前期设计；其次，在这个过程中对覆铜板企业柔性化生产体系和快速打样能力提出更高的服务要求。

未来发展趋势将以具身智能、AI 算力、数据中心、6G 通信、智能网联汽车为核心的增长赛道，以高速、高可靠性为技术演进方向，产业链协同将进一步强化，“联合研发、定制化供应、长期供应保障”将成为行业的新业态，行业的认证门槛和高端市场集中度将进一步提升。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	6,011,550,274.30	4,571,590,456.20	31.50	4,494,749,084.66
归属于上市公司 股东的净资产	2,877,072,152.44	2,429,218,071.86	18.44	2,447,255,553.93
营业收入	5,227,828,810.43	3,361,541,042.55	55.52	2,982,830,513.76
利润总额	259,318,224.05	49,695,791.42	421.81	-161,814,324.93

归属于上市公司股东的净利润	240,327,620.48	50,320,174.62	377.60	-129,490,006.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,017,399.69	28,042,389.50	677.46	-150,566,431.59
经营活动产生的现金流量净额	-83,184,590.91	325,310,349.60	-125.57	25,929,989.29
加权平均净资产收益率(%)	9.12	2.06	增加7.06个百分点	-5.06
基本每股收益(元/股)	1.07	0.22	386.36	-0.57
稀释每股收益(元/股)	1.06	0.22	381.82	-0.57
研发投入占营业收入的比例(%)	5.06	5.09	减少0.03个百分点	6.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	952,450,782.15	1,352,604,627.36	1,358,278,459.21	1,564,494,941.71
归属于上市公司股东的净利润	21,120,712.02	66,069,438.79	70,908,456.71	82,229,012.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,036,583.99	65,165,708.55	62,790,889.02	74,024,218.13
经营活动产生的现金流量净额	-137,046,502.84	66,804,994.71	42,615,617.41	-55,558,700.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,675
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,119
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)	

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海南亚科技集团有 限公司		126,048,600	53.69		无	0	境内非 国有法 人
包秀银	-3,735,275	11,210,268	4.77		无	0	境内自 然人
深圳市恒邦兆丰私募 证券基金管理有限公 司—恒邦企成1号私 募证券投资基金	-5,497,466	5,508,765	2.35		无	0	其他
包秀春		2,597,621	1.11		无	0	境内自 然人
郑晓远	-150,000	2,263,910	0.96		无	0	境内自 然人
中国工商银行股份有 限公司—国泰估值优 势混合型证券投资基 金(LOF)		2,057,680	0.88		无	0	其他
中国建设银行股份有 限公司—国寿安保智 慧生活股票型证券投 资基金	169,836	2,050,837	0.87		无	0	其他
中国银行股份有限公司 —摩根士丹利数字 经济混合型证券投资 基金		1,673,615	0.71		无	0	其他
香港中央结算有限公 司	1,033,002	1,645,332	0.7		无	0	其他
郑广乐		1,549,853	0.66		无	0	境内自 然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海南亚科技集团有限公司为公司控股股东;包秀银、包秀春、郑广乐为一致行动人;郑晓远为公司董事。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

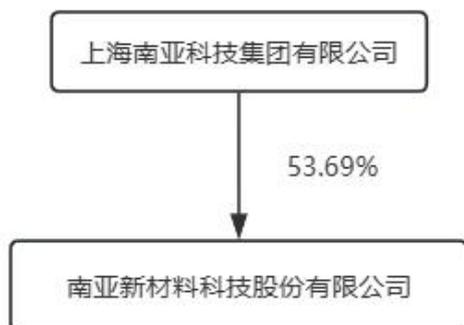
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

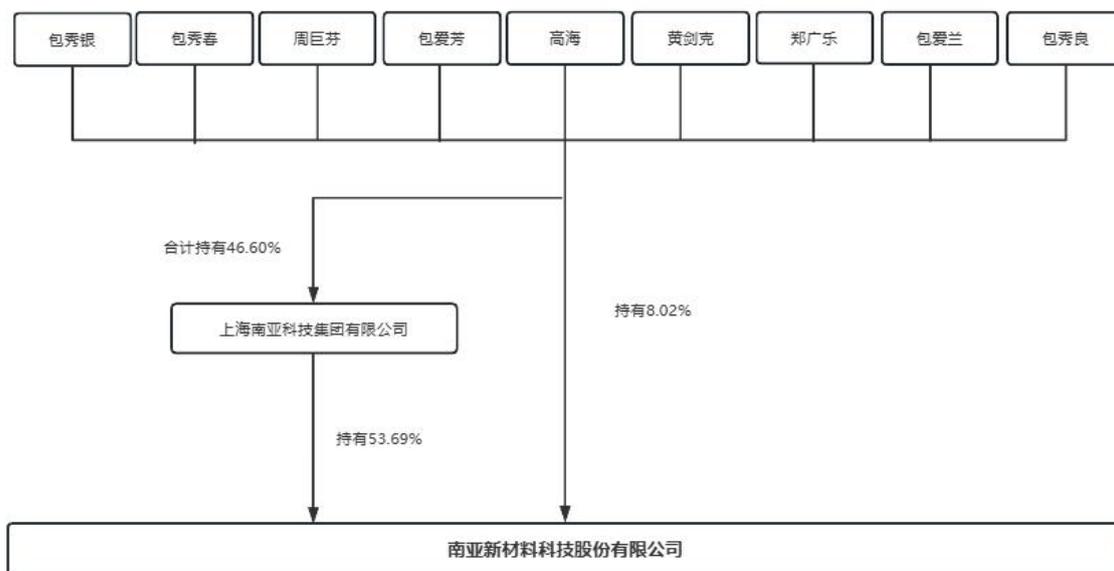
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对

公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“二、经营情况的讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用